

Title (en)

DRY SCREED SYSTEM, METHOD FOR LAYING AND PRODUCING, AND USE OF A DRY SCREED SYSTEM

Title (de)

TROCKENESTRICH-SYSTEM, VERFAHREN ZUM VERLEGEN UND HERSTELLEN SOWIE VERWENDUNG EINES TROCKENESTRICH-SYSTEMS

Title (fr)

SYSTÈME DE CHAPE SÈCHE, PROCÉDÉ DE POSE ET DE FABRICATION ET UTILISATION D'UN SYSTÈME DE CHAPE SÈCHE

Publication

**EP 4332323 A2 20240306 (DE)**

Application

**EP 23193933 A 20230829**

Priority

DE 102022003200 A 20220901

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft ein auf einem Boden (2) oder Untergrund (2) verlegbareres Trockenestrich-System (1). Das Trockenestrich-System umfasst eine aus Basisplatten (7) gebildete Basisschicht (25) und zumindest eine aus Deckplatten (8) gebildete Deckplatten-Schicht (26). Die Basisplatten (7) enthalten Gips oder sind aus Gips gebildet. Die Deckplatten (8) enthalten biegesteifes Holz oder einen biegesteifen Holzwerkstoff oder sind aus biegesteifem Holz oder aus einem biegesteifen Holzwerkstoff gebildet. Die Deckplatten (8) sind auf den Basisplatten (7) verklebbar. Auf den Basisplatten (7) und/oder den Deckplatten (8) ist eine Positionierhilfe (12) angeordnet, welche beim Auslegen oder nach dem Auslegen der Basisplatten (7) sichtbar ist, und welche die Position der auf den Basisplatten (7) anordbaren Deckplatten (8) so vorgibt, dass sich zwischen Basisplatte (7) und Deckplatte (8) nach dem Auslegen jeweils zumindest ein Versatz (21) ausbildet, der größer ist ca. als 10 cm, insbesondere im Bereich von ca. 10 cm bis ca. 40 cm, vorzugsweise ca. 30 cm.

IPC 8 full level

**E04F 15/02** (2006.01); **E04F 15/04** (2006.01); **E04F 15/18** (2006.01)

CPC (source: EP)

**E04F 15/0215** (2013.01); **E04F 15/02155** (2013.01); **E04F 15/04** (2013.01); **E04F 15/18** (2013.01)

Designated contracting state (EPC)

AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC ME MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)

BA

Designated validation state (EPC)

KH MA MD TN

DOCDB simple family (publication)

**EP 4332323 A2 20240306**; **EP 4332323 A3 20240313**; DE 102022003200 A1 20240307

DOCDB simple family (application)

**EP 23193933 A 20230829**; DE 102022003200 A 20220901